

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/201687 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 11/08 (2006.01) C09J 7/30 (2018.01)
C09J 163/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/047140
- (22) 国際出願日: 2021年12月20日(20.12.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-052762 2021年3月26日(26.03.2021) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 大谷 洋多(OTANI, Yota); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 丸山 弘光(MARUYAMA, Hiromitsu); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: DICING DIE ATTACH FILM, METHOD FOR PRODUCING SAME, SEMICONDUCTOR PACKAGE, AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: ダイシングダイアタッチフィルム及びその製造方法、並びに半導体パッケージ及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: A dicing die attach film which has a dicing film and a die attach film layered on this dicing film, wherein the die attach film contains an organic solvent which has a boiling point no less than 100 °C and less than 150 °C and a vapor pressure of 50 mmHg or less, and the content of the organic solvent in the die attach film satisfies formula (a). (a) When 1.0g of the die attach film is immersed in 10.0mL of acetone for 24 hours at 4 °C, the extracted organic solvent concentration in said acetone is 800µg or less.

(57) 要約: ダイシングフィルムと、このダイシングフィルム上に積層されたダイアタッチフィルムとを有するダイシングダイアタッチフィルムであって、前記ダイアタッチフィルムが沸点100℃以上150℃未満かつ蒸気圧50mmHg以下の有機溶媒を含み、前記ダイアタッチフィルム中の有機溶媒量が下記(a)を満たす、ダイシングダイアタッチフィルム。(a) ダイアタッチフィルムの1.0gをアセトン10.0mL中に4℃で24時間浸漬したとき、該アセトン中に抽出される有機溶媒濃度が800µg以下。

[続葉有]

WO 2022/201687 A1

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）